

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他 _____</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 申万宏源、玖鹏资产、正兴私募、南方基金、国泰海通、诚通基金、广润投资、南华基金、凯联资本、华泰证券、中非信银、偕沣私募、万家基金、珏岩投资、广发证券、万联证券、添橙私募、锦道投资、九方智投、五矿证券、清水源投资、长江证券、光大自营、天治基金、上犹益憬、华泰资产、财通证券、新华基金、禾永投资、兴合基金、新沃基金、阳光资产、博时基金、建信养老                                                                                                                                                                                  |
| 时间            | 2026 年 9 月 2 日-9 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地点            | 上海、北京                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上市公司接待人员姓名    | 证券事务代表 魏兴尧<br>投资者关系 李蓝天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1、公司半年报净利润同比下滑较多的原因是什么？</div> <div>主要原因是受到行业宏观因素及下游订单节奏影响,T/R 组件及射频模块收入减少，同时公司持续加大研发投入所致。</div> <div>2、上半年研发投入同比增加的原因是什么？</div> <div>2026 年上半年，公司研发投入总额达 1.75 亿元，较上年增长 34.16%，主要系公司持续加大研发投入，研发用材料和研发测试设计费较上年同期增长所致。公司正在围绕 5G-A/6G 高效高线性射频前端模组及核心器件、基于国产半导体工艺的毫米波核心技术、下一代探测和通信用高频收发前</div>                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>端、微波毫米波高密度集成工艺技术项目积极开展研发。</p> <p>3、2026 年上半年收入中 T/R 组件、射频模块和射频芯片业务的占比如何拆分？</p> <p>根据公司披露的半年度报告，T/R 组件和射频模块合计实现营收 7.27 亿元，射频芯片实现营收 1.21 亿元，其他芯片实现营收 0.25 亿元。</p> <p>4、2026 年全年的业绩如何展望？是否能实现增长？</p> <p>2026 年，公司聚焦射频主业，持续加大研发投入，扎实推进经营管理工作。受行业宏观因素及下游订单节奏影响，公司一季度业绩出现一定波动，二季度起伴随下游需求逐步恢复、新一代产品交付加快，经营态势环比改善。</p> <p>下半年，公司将继续聚焦有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路核心业务，紧扣巩固核心业务优势、布局战新产业领域、强化创新体系建设、优化运营管理体系主线，围绕第十五个五年规划开局之年的政策和市场机遇，持续优化产品结构、重点保障客户交付节点。</p> <p>5、2026 年上半年公司毛利率下降的原因是什么，以及未来的毛利率水平如何展望？</p> <p>公司主营业务毛利率总体保持在一个稳定的区间内，受到产品结构调整等因素影响会出现一定波动。公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用、自研芯片等措施来提高生产效率、降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定。</p> <p>6、目前公司的在手订单情况如何？</p> <p>根据公司公开披露的公告，截至 2026 年 3 月 31 日，公司在 T/R 组件领域的在手订单约 9.46 亿元，在射频集成电路领域的在手订单约 2.5 亿元。</p> <p>7、公司的 T/R 组件业务未来如何展望？</p> <p>在相控阵雷达领域，信息技术发展带来模式改变，信息</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>化建设的重要程度日益彰显。相控阵雷达作为现代雷达技术的主流，其核心部件 T/R 组件的需求量持续攀升。公司紧跟行业发展趋势和重点预研动向，围绕用户需求进行产品策划，深度参与多个重点项目，积极开拓新的市场。</p> <p>同时，公司积极开展 T/R 组件应用领域拓展，在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已大批量交付客户。</p> <p>2026 年是“十五五”开局之年，随着“十五五”新一轮装备建设发展和订单落地，公司 T/R 组件业务有望迎来新的发展机遇，同时公司也会依托核心技术优势加强和客户的沟通，积极参与项目竞标，争取更多订单。</p> <p>8、公司今年的基站业务情况如何？以及在 5G-A、6G 基站上有何布局？</p> <p>公司的 GaN 射频模块覆盖多个频段，金属陶瓷封装、塑封、OMP 等封装形式实现应用场景全覆盖，多款产品应用于 4G、5G、U6G 移动通信基站，是国内移动通信基站射频器件的核心供应商。</p> <p>2026 年，随着 5G 基站升级、5G-A 的全面布网、U6G 频段及技术的加速落地，对基站射频器件的需求和用量持续增加，射频模块业务有望呈现积极发展态势。目前公司射频模块业务稳步开展，为国内多家移动通信设备制造商批量供货。多款射频集成电路产品已应用于 5G-A 基站中，在 5G-A 移动通信崭露头角。在 NTN 领域和低空经济领域，推出多款产品支撑 6G“空天地海”一体化架构建设、参与低空经济建设。</p> <p>9、2026 年上半年公司在卫星领域的收入有多少？</p> <p>2026 年，公司依托三代半导体氮化镓技术和产品，积极开拓低轨卫星、商业航天等新兴应用领域，多款 T/R 组件产品已大批量交付客户。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>目前我国商业航天正处于从技术验证向规模化商业运营转变的关键阶段，公司有望凭借在氮化镓芯片/组件领域的技术优势和批量化供货能力，成为商业航天领域的重要参与者。</p> <p>10、公司在卫星上的单星价值量有多少？</p> <p>公司应用于星载领域的产品以有源相控阵 T/R 组件为主，还包括部分模块、芯片，在产业链中处于中上游的位置。2026 年，公司积极布局卫星领域业务方向，持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足日益增长的市场需求。针对通信、遥感、导航等不同类型的卫星载荷，公司定制化研发相应产品。具体产品价格涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>11、公司在星网二代星项目的参与情况如何？</p> <p>作为国内卫星载荷 T/R 组件和射频集成电路产品的主要供应商之一，公司与卫星载荷客户保持良好的合作关系，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。</p> <p>12、目前公司的硅基氮化镓功放芯片应用情况如何？今年是否会大规模放量？</p> <p>2026 年，公司的硅基氮化镓功放芯片持续向客户批量供货。根据公开资料和公司公告，随着终端应用对射频功放要求的持续提升，大功率、高带宽、高效率射频功放成为技术发展趋势，当前主流的砷化镓射频功放技术受限于材料特性，面临性能局限性的挑战。硅基氮化镓功放芯片具备新型三代半导体材料的性能优势，将随着硅基氮化镓功放芯片产业链的技术进步和规模扩张，进一步扩大产品优势并持续提升。预计公司新产品将持续对现有砷化镓终端功放产品形成替代，并有望在终端射频功放领域全频段、全场景推广应用。具体情况涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>13、公司在手机端的客户有哪些？有什么拓展计划？</p> <p>根据与客户的合作协议，客户信息属于公司商业敏感信息，对外披露可能引致不当竞争及损害公司利益，公司暂无法披露客户的具体名称。</p> <p>14、公司在终端领域有没有新产品开发计划？</p> <p>公司针对卫星互联网各类终端开展了产品开发，尤其在终端直连卫星实现高速高通量网络服务领域，公司开发的产品处于行业最前沿，是目前终端直连卫星互联网的先进方案之一。具体情况请关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>15、公司在市值管理方面有哪些具体措施？</p> <p>公司高度重视市值管理工作，坚持以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，持续加强产品研发和市场开拓，提升核心竞争力，努力提高经营效率和盈利能力，以良好的业绩回报股东，推动公司高质量发展。公司高度重视投资者关系管理，持续推动与资本市场建立良性交流机制，保证各投资方公平、平等获取公司信息，让国博电子的发展取得市场的认可。</p> <p>16、公司近期是否有股权激励的计划？</p> <p>公司如有相关计划，将严格按照规定履行信息披露义务。</p> |
| 附件清单（如有）     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 日期           | 2026 年 9 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |